

说明

本应用笔记详细介绍了如何使用沁恒微电子（WCH）的高性能 RISC-V 微控制器 CH32H417 的高速 SDMMC 接口，来驱动嵌入式多媒体卡（eMMC）和从模式通信。eMMC 集成了 NAND Flash 和控制器，并采用标准 MMC 接口，提供了高集成度、高可靠性和简化的软件驱动方式，是嵌入式大容量存储的首选方案之一。CH32H417 的 SDMMC 主机控制器完全兼容 eMMC 协议，支持高达 200MHz 的时钟频率，可实现高速的数据读写。本文将围绕 SDMMC 接口介绍、接口硬件设计、协议基础和软件驱动配置进行详细说明。

适用范围

适用范围	系列
通用 MCU	CH32H417/CH32H416

目录

说明 ······	i
目录 ······	ii
表格索引 ······	ii
图片索引 ······	iii
第1章 简介 ······	1
1.1 CH32H417 芯片简介 ······	1
1.1.1 SDMMC 接口概述 ······	1
1.1.2 SDMMC 接口特性 ······	1
1.2 SD、SDMMC 与 eMMC 概念 ······	2
1.3 协议简介 ······	2
1.4 常用术语解释 ······	2
第2章 硬件设计与接口规范 ······	3
2.1 接口引脚定义 ······	3
2.2 核心电路设计 ······	3
2.3 PCB 布局布线指南 ······	4
第3章 协议基础 ······	5
3.1 命令格式 ······	5
3.2 响应格式 ······	5
3.3 数据包格式 ······	5
第4章 软件驱动开发 ······	6
4.1 初始化配置 ······	6
4.2 命令配置 ······	7
4.3 数据配置 ······	7
4.3.1 单缓冲模式 ······	7
4.3.2 双缓冲模式 ······	8
4.4 时序调整 ······	8
4.5 中断配置 ······	9
第5章 eMMC 驱动流程实例 ······	10
5.1 High Speed SDR 配置流程 ······	10
5.2 High Speed DDR 配置流程 ······	11
5.3 HS200 配置流程 ······	12
5.4 HS400 配置流程 ······	12
历史版本 ······	13
声明 ······	14

表格索引

表 1-1 SDMMC 接口特性 ······	1
表 2-1 SDMMC 接口定义 ······	3
表 2-2 SDMMC 映射引脚 ······	3
表 3-1 命令格式 ······	5
表 3-2 响应格式 ······	5
表 4-1 引脚初始化配置 ······	6

表 5-1 eMMC 模式 · · · · ·	10
表 5-2 CID 信息 · · · · ·	10

图片索引

图 2-1 eMMC 卡接线图 · · · · ·	3
图 2-2 主从通信等长布线 PCB 图 · · · · ·	4
图 4-1 SDMMC 时钟树 · · · · ·	6
图 4-2 SDR 模式时序图 · · · · ·	8
图 4-3 DDR 模式时序图 · · · · ·	9

第1章 简介

1.1 CH32H417 芯片简介

CH32H417 是基于青稞 RISC-V5F 和 RISC-V3F 双内核设计的互联型通用微控制器。它集成了一个完整的 SDMMC 主机控制器（兼容 SD/MMC/SDIO 协议），该控制器支持 eMMC 设备，可配置工作在 1 位、4 位或 8 位总线模式下，最高通信时钟可达 200MHz，为大数据量的存储提供了硬件基础。

1.1.1 SDMMC 接口概述

系统提供 1 组 SDMMC 控制器主机/从机接口，传输时钟可达 200MHz，支持双沿采样，支持 1/4/8 线通讯模式，可外接 SD/TF 卡、eMMC 卡等器件。应用程序代码可灵活设置数据收发的各种命令、应答包、有效数据包的模式和长度，双缓冲长度切换界限等参数。

SDMMC 接口的主要特性如下：

- 支持 SD 物理层 1.0、2.0 规范，支持 SD3.0 规范的 UHS-I SDR50、DDR50 和 SDR104 模式
- 符合 eMMC 卡 4.4 和 4.5.1 规范；支持 eMMC 卡 5.0 规范的 HS200, HS400
- 通讯模式支持单线、四线、八线模式
- 最高通讯时钟可达 200MHz
- 支持双沿采样
- 灵活可设置的数据包长度、命令格式、应答状态
- 提供硬件自动在数据块间隔时停止时钟功能
- 支持 SD 卡、SDIO 卡、eMMC 卡等符合 SD 接口协议的设备
- 支持 SDIO 从机接口，可以完成支持 SDIO 主机接口的芯片的数据交换
- DMA 双缓冲功能

1.1.2 SDMMC 接口特性

表 1-1 SDMMC 接口特性

符号	参数	条件	最小值	最大值	单位
f_{CK}/t_{CK}	数据传输模式下的时钟频率	$CL \leq 30\text{pF}$		100	MHz
		$CL \leq 10\text{pF}, V_{DD18} = 1.8\text{V}$		200	MHz
$t_{W(CKL)}$	时钟低电平时间	$CL \leq 10\text{pF}$	2.2		ns
$t_{W(CKH)}$	时钟高电平时间	$CL \leq 10\text{pF}$	2.2		
$t_r(CK)$	上升时间	$CL \leq 10\text{pF}$		1.2	ns
$t_f(CK)$	下降时间	$CL \leq 10\text{pF}$		1.2	
CMD/DAT 输入（参考 CK）					
t_{ISU}	输入建立时间	$CL \leq 10\text{pF}$	0.4		ns
t_{IH}	输入保持时间	$CL \leq 10\text{pF}$	0.4		
在高速模式下，CMD/DAT 输出（参考 CK）					
t_{OV}	输出有效时间	$CL \leq 10\text{pF}$	主模式	1.2	ns
			从模式	6	
t_{OH}	输出保持时间	$CL \leq 10\text{pF}$	4.5		
在默认模式下，CMD/DAT 输出（参考 CK）					
t_{OVD}	输出有效默认时间	$CL \leq 10\text{pF}$	主模式	1.2	ns
			从模式	6	
t_{OHD}	输出保持默认时间	$CL \leq 10\text{pF}$	4.5		

1.2 SD、SDMMC 与 eMMC 概念

- **SD Card (Secure Digital Memory Card)**：一种遵循 SD 标准，主要用于存储数据的闪存卡。协议主要包含物理层（Physical Layer）、文件系统层（File System Layer）和应用层（Application Layer）。
- **SDMMC (SD/EMMC Controller)**：在 SD 标准基础上扩展的接口标准，允许设备在共享 SD 接口的基础上实现额外功能。常见的 SDMMC 接口设备包括 Wi-Fi 模块、蓝牙模块、GPS 模块等。SDMMC 设备在初始化后，主机可以通过特定的 I/O 命令与其功能单元（Function）进行通信，而非简单的块读写。
- **eMMC (embedded MultiMediaCard)**：将 MMC 接口、NAND Flash 及主控制器集成在一个 BGA 封装内的嵌入式存储解决方案。它对主机隐藏了 NAND 管理的复杂性，提供了与 SD 卡类似的块设备接口，但引脚定义和部分高级特性存在差异。

1.3 协议简介

SD 协议采用主从式、命令-响应型的串行通信方式。

- **总线拓扑：**

支持 1 个主机（Host）和多个从设备（Card）的连接。通过设备地址（RCA）进行寻址。

- **通信通道：**

CMD 线：用于双向传输命令和响应。该信号是一个双向命令通道，用于设备的初始化和命令传输。CMD 信号有两种工作模式：初始化模式为开漏模式，快速命令传输推挽模式。命令从主机控制器发送到从设备，响应从设备发送到主机。

DAT 线：用于双向传输数据。支持 1-bit、4-bit、8-bit 模式。

CLK 线：由主机产生，为所有传输提供同步时钟。该信号每个周期在 CMD 线上进行一位传输，在所有 DAT 线上进行一位 (1x) 或两位 (2x) 传输。频率可以在零到最大时钟频率之间变化。

- **数据传输模式：**

分为单数据速率（SDR）和双数据速率（DDR）

1.4 常用术语解释

- **RCA (Relative Card Address)**：主机在初始化过程中分配给卡的相对地址，用于后续寻址。
- **CID (Card Identification Number)**：卡的唯一标识符，包含制造商、序列号等信息。
- **CSD (Card Specific Data)**：卡的特性数据，包含容量、块大小、支持的最大传输速度等信息。
- **OCR (Operating Conditions Register)**：操作条件寄存器，包含卡的电压范围和支持的模式信息。
- **Block (块)**：eMMC 卡读写的最小逻辑单位，通常为 512 字节

第2章 硬件设计与接口规范

2.1 接口引脚定义

SDMMC 接口共有 11 根接口线，一根时钟线（CLK），一根命令线（CMD），八根数据线（DAT[7:0]）和一根数据选通信号线（STR），每根线的类型和描述如下表。

表 2-1 SDMMC 接口定义

SD/EMMC 引脚	类型	描述
CLK	主机输出 从机输入	同步时钟信号
CMD	双向，开漏	命令/响应信号线，必须上拉。
DAT[7:0]	双向，开漏	数据线。至少需要 DAT0。必须上拉。
STR	从机输出	返回时钟信号，用于 HS400 模式
VDD	电源	核心供电电压（3.3V 典型值）
VCCQ	电源	I/O 供电电压（3.3V→1.8V）
VSS	电源	地
RST	输入	硬件复位，默认上拉，低电平复位

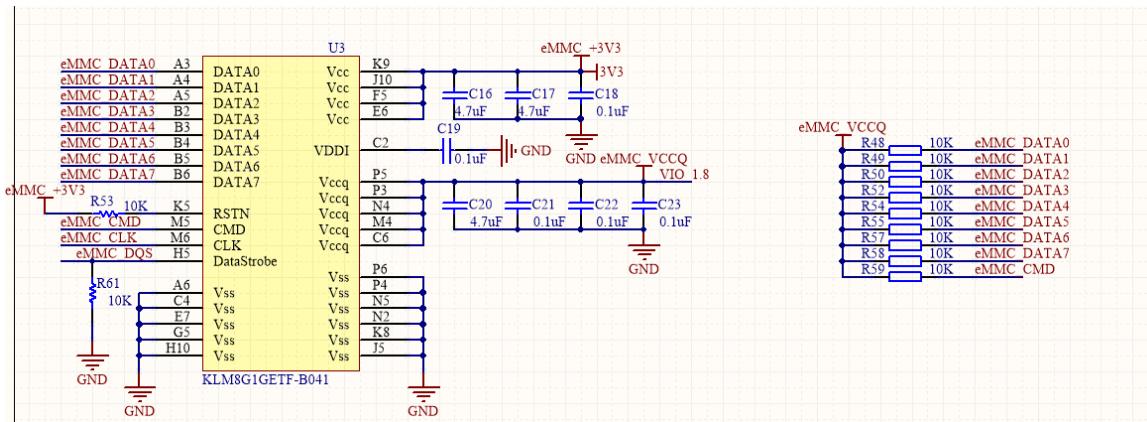
注：STR 信号由设备生成，用于 HS400 模式下的输出。该信号的频率跟随 CLK 的频率。对于数据输出，该信号的每个周期都会在数据上传输两个位（2x）——一个位用于正边沿，另一个位用于负边沿。对于 CRC 状态响应输出和 CMD 响应输出仅在 HS400 增强型脉冲模式下启用），CRC 状态和 CMD 响应仅在正边沿被锁存，而在负边沿不关心。

2.2 核心电路设计

上拉电阻：CMD 和所有 DAT 线必须使用电阻上拉到 VDD。这是协议强制要求的，用于确保在总线空闲时处于高电平状态，并提供稳定的直流偏置。即使 MCU 内部有上拉，也强烈建议使用更可靠的外部上拉电阻。

电源电路：提供干净、稳定的电源。电源引脚必须并联多个电容进行去耦。

图 2-1 eMMC 卡接线图



CH32H417QE6 提供了三组 SDMMC 映射引脚，根据封装可以选择对应的组，CH32H417 对应的 SDMMC 引脚如下表：

表 2-2 SDMMC 映射引脚

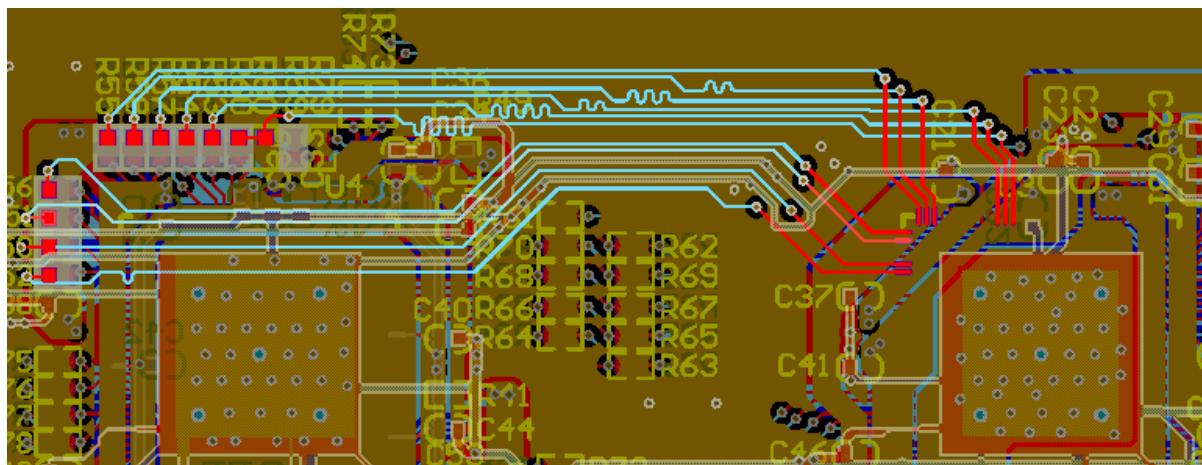
SDMMC 功能	SDMMC_RM=00 默认映射引脚	SDMMC_RM=01 重映射引脚	SDMMC_RM=1x 重映射引脚
----------	-----------------------	----------------------	----------------------

SDMMC_STS/SDMMC_CMD	PD2	PD12	PC10
SDMMC_SDCK/SDMMC_SLVCK	PC12	PD11	PC12
SDMMC_STR	PD3	PD10	PC11
SDMMC_D0	PC8	PB13	PD0
SDMMC_D1	PC9	PC9	PD1
SDMMC_D2	PC10	PB10	PD2
SDMMC_D3	PC11	PB11	PD3
SDMMC_D4	PA14	PA14	PD4
SDMMC_D5	PA15	PA15	PD5
SDMMC_D6	PC6	PC6	PD6
SDMMC_D7	PC7	PC7	PD7

2.3 PCB 布局布线指南

- 等长布线：对于 DAT[3:0] 一组信号线，走线长度差异应控制在 150mil（约 3.8mm）以内。在 eMMC 8-bit 模式下，DAT[7:0] 最好也能做等长处理。
- 优先布线：CLK 线应尽可能短，并远离其他高速信号和模拟信号，以减少干扰。
- 参考平面：所有 SDMMC 信号线下方必须有完整的地平面作为参考，避免跨分割。
- 过孔：尽量减少过孔数量，如需使用，应使用小尺寸过孔

图 2-2 主从通信等长布线 PCB 图



第3章 协议基础

3.1 命令格式

所有命令帧均为 48 位固定长度，格式如下：

表 3-1 命令格式

位	47	46	45:40	39:8	7:1	0
值	0	1	Index	Argument	CRC7	1
说明	起始位	传输位	命令号	命令参数	校验位	结束位

示例：CMD0 (GO_IDLE_STATE)：重置所有卡到空闲状态。

- Index = 0x0
- Argument = 0x00000000
- CRC7 = 0x94 (对于 CMD0, CRC 是可选的, 但通常发送这个值)
- 最终 48 位数据: 0x400000000095

3.2 响应格式

最常见的响应是 R1 (48 位), 格式如下:

表 3-2 响应格式

位	47	46	45:40	39:8	7:1	0
值	0	0	Index	Card Status	CRC7	1
说明	起始位	传输位	原命令号	32 位状态寄存器	校验位	结束位

在 32 位状态寄存器中, 每一位代表一个状态, 例如第 31 位是 ADDRESS_OUT_OF_RANGE 错误, 第 8 位是 READY_FOR_DATA (表明卡已准备好传输数据)。

3.3 数据包格式

数据通过 DAT 线传输, 以数据块为单位。每个数据块前有一个起始位, 后跟数据内容和 CRC16 校验码。

- 读数据 (设备 → 主机):

[Start Bit (0)] + [Data] + [CRC16] + [End Bit (1)]
- 写数据 (主机 → 设备):

[Start Bit (0)] + [Data] + [CRC16] + [End Bit (1)]

数据块大小可以在初始化时配置 (通常为 512 字节, 与硬盘扇区兼容)。在 HS400 等高速模式下, 数据在时钟的上升沿和下降沿都会传输 (DDR)。

第4章 软件驱动开发

4.1 初始化配置

SDMMC 初始化配置，首先对所用到的 GPIO 进行配置，选择实际的映射引脚，IO 速度等。

表 4-1 引脚初始化配置

SD/EMMC 引脚	配置
CLK	主模式：推挽复用输出 从模式：推挽复用输出
CMD	推挽复用输出
D [7:0]	推挽复用输出（根据配置的有效数据宽度配置引脚个数）
STR	推挽复用输出（HS400 模式需要时配置）

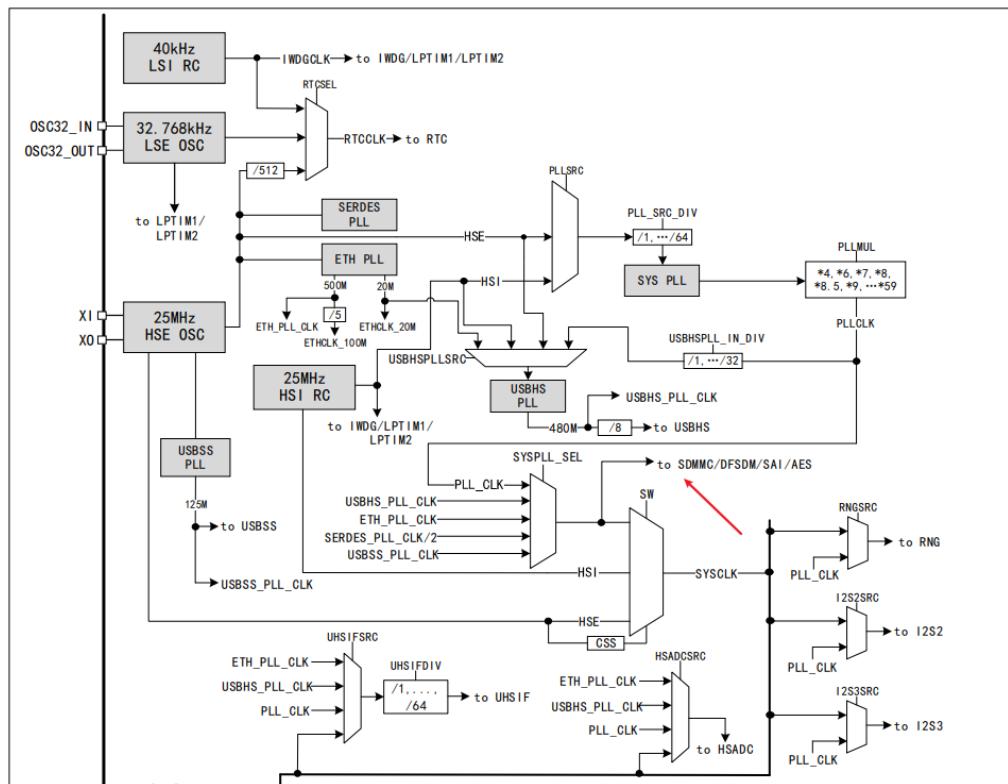
接下来就是配置对应的 SDMMC 寄存器，实现相应功能。

首先选择 SDMMC 的角色，配置 RB_SLV_MODE，设为主机或者从机模式。

紧接着就是配置时钟，控制器接口提供了 2 种时钟模式：低速模式和高速模式。一般 SD 协议规定对于 SD 接口的设备的前期初始化使用 400KHz 左右的通讯时钟来保证更好的通讯兼容性，当获取了外接设备的参数信息后，可以根据其内部支持的配置，切换到更高的时钟频率进行通讯。

图 4-1 SDMMC 时钟树

图 3-2 时钟树框图（仅适用于批号第五位为 0 的芯片）



根据时钟树的指示，SDMMC 的时钟来源于 SYSPLL_SEL，根据 R16_EMMC_CLK_DIV 寄存器中的 RB_EMMC_CLKOE 选择：

当 RB_EMMC_CLKMode = 1，则 SDCLK = SYSPLL_SEL/RB_EMMC_DIV_MASK；

当 RB_EMMC_CLKMode = 0，则 SDCLK = SYSPLL_SEL/RB_EMMC_DIV_MASK/64。

最小值为 2，写 1 等效关闭 SDC 模时钟。主机经过上述配置后对外输出对应时钟，从机的时钟为直接输入值，无需经过上述的计算，但是 RB_EMMC_DIV_MASK 必须配置成最小值 2。通讯时钟最大支

持输出 200M。

在和外部 SDIO 接口设备通讯时，由于较高的时钟频率、硬件走线、器件特性等因素，会导致信号采样出错。系统 SDIO 控制器主机接口提供了输出时钟相位翻转（偏移 180°）功能，通过设置寄存器 R16_EMMC_CLK_DIV 寄存器的 bit10 位写 1，可以让输出的时钟信号物理翻转，但是控制器内部的时钟仍然保持不变。这种方式可以调节通讯时序。在 SDR 模式下，可以更改 RB_EMMC_NEGSMP 位，改变数据采样边沿，以此来改善通讯时序。

根据实际使用的数据位宽，配置 RB_EMMC_LW_MASK 位，根据配置，选择 1/4/8 线模式，根据协议规定，初始化 SD/EMMC 时，使用单线模式，数据通讯时，SD 一般选择 4 线模式，EMMC 一般选择 8 线模式。

如果需要对收发器进行复位，可以 RB_EMMC_RST_LGC 位和 RB_EMMC_ALL_CLR 位先写 1，再写 0。正常使用控制器前需确保上述两位为 0。

为了后续数据的顺利收发，初始化时期，配置 RB_EMMC_DMAEN，使能 DMA。配置 RB_EMMC_TOCNT_MASK，设置应答/数据超时时间：SDCLK * 4194304 * RB_EMMC_TOCNT_MASK，当发生如下四种情况时，对应的超时中断标志就会置位。

- 1) R1b 应答之后的 D[0] busy 超时；
- 2) 写数据块时，CRC status 之后的 D[0] busy 超时；
- 3) 写数据块时，等待 CRC status 超时；
- 4) 读数据块时，等待起始位超时。

4. 2 命令配置

主机发送 CMD，配置 EMMC_ARGUMENT（参数），RB_EMMC_CMDIDX_MASK（发送的索引号）和 RB_EMMC_RPTY_MASK（期望的应答类型），从机返回的响应参数存在 R32_EMMC_RESPONSE 寄存器中。

从机接收 CMD，接收到的参数存在 R32_EMMC_RESPONSE3 中，接收的索引存在 R32_EMMC_RESPONSE2 中，回复主机的响应参数需写入 EMMC_ARGUMENT。

4. 3 数据配置

数据配置时，主机和从机采用同样的配置方式。为了防止读写之间抢占，可以在读和写之前，查看 R32_EMMC_STATUS 寄存器的 RB_EMMC_DATOSTA 位，查看数据线 D0 的状态，等到高电平之后再进行读写操作。

4. 3. 1 单缓冲模式

发送数据时，RB_EMMC_MODE_BOOT 设置为正常模式，RB_EMMC_DMA_DIR 设置传输的方向为控制器到 SD。设置发送单块传输大小 RB_EMMC_BKSIZE_MASK（1~2048 字节），设置发送的传输块总数 RB_EMMC_BKNUM_MASK（1~65535 块），最后配置 R32_EMMC_DMA_BEG1 寄存器，将用于存储发送数据缓存区起始地址写入，注意 16 字节对齐，开始发送数据。

接收数据时，RB_EMMC_MODE_BOOT 设置为正常模式，RB_EMMC_DMA_DIR 设置传输的方向为 SD 到控制器。配置接收的单块传输大小 RB_EMMC_BKSIZE_MASK（1~2048 字节），设置接收的传输块总数 RB_EMMC_BKNUM_MASK（1~65535 块），最后配置 R32_EMMC_DMA_BEG1 寄存器，将用于存储数据缓存区起始地址写入，注意 16 字节对齐，开始等待接收数据。

如需使用 DDR 模式，则在上述的基础上开启 RB_DDR_MODE 位使能 DDR。

如果连续读写多块，在每完成一块后，需要写入 R32_EMMC_WRITE_CONT 任意值，以启动下一块的发送。

主从通信时，如果从机在收发过程中出现内部 FIFO 溢出，硬件会自动强制本次收发的数据块为 CRC 错误，以此通知主机传输有问题；从机可以设置 RB_SLV_FORCE_ERR，强制回复主机数据块 CRC 错

误。

4.3.2 双缓冲模式

根据 4.3.1 配置发送和接收模式，在以上基础上需再使能 RB_EMMC_DUEDMA_EN，开启双缓冲模式，配置 RB_EMMC_DMATN_CNT 位，设置缓冲区切换的块计数值，配置 R32_EMMC_DMA_BEG2 寄存器，用于存放另一个数据缓存区起始地址。

当 R32_EMMC_DMA_BEG1 寄存器地址开始的数据块长度阈值传输完成，硬件将切换到 R32_EMMC_DMA_BEG2 设置地址区域进行数据传输，并在达到传输阈值后再次切换到 R32_EMMC_DMA_BEG1 区，以此循环，直到 RB_EMMC_BKNUM_MASK 配置的总数据块数量全部传输完成。

4.4 时序调整

在较高 SDCLK 频率下，若推荐的时序调节寄存器值不能稳定通信，用户需发起总线采样 tuning 序列寻找更佳的采样点。

可以通过示波器观察数据采样波形，根据观测到的波形调整对应的延迟。此时不要使用逻辑分析仪，一般的逻辑分析仪采样速率已经无法正确采样数据收发的波形。

以主从机通信，主机发送从机接收为例：

1、如果 CLK 采样边沿慢于有效数据

主机端可以调整 R32_EMMC_TUNE_DAT0 寄存器，设置单根数据线输出延时，输出延迟=0.1ns * RB_TUNNE_DATx_0；

从机端可以调整 R32_EMMC_TUNE_DAT1 寄存器，设置单根数据线输入延时，输入延迟=0.1ns * RB_TUNNE_DATx_1；

2、如果 CLK 采样边沿快于有效数据

主机端可以配置 RB_TUNNE_CLK_0 位，延迟 CLK 输出，延迟=0.2ns * RB_TUNNE_CLK_0；

从机端可以配置 RB_TUNNE_CLK_1 位，延迟 CLK 输入，延迟=0.2ns * RB_TUNNE_CLK_1；

通过 1 和 2 的配置将有效数据位正确对应在 CLK 的采样边沿上。

图 4-2 SDR 模式时序图

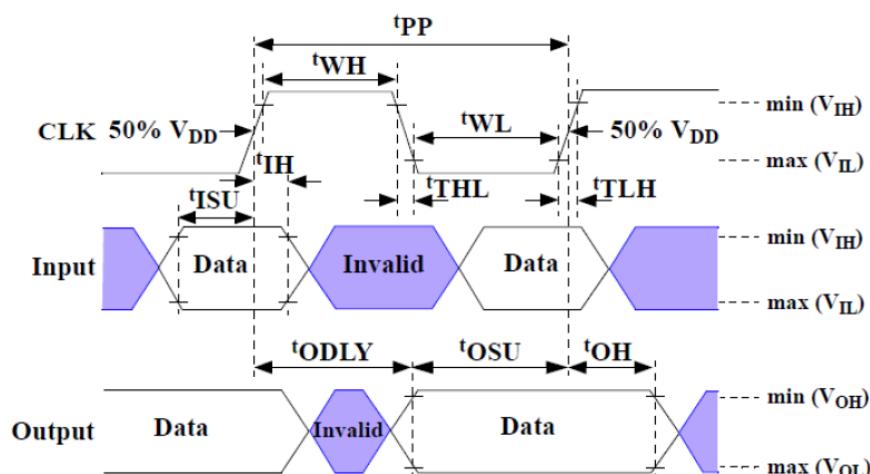
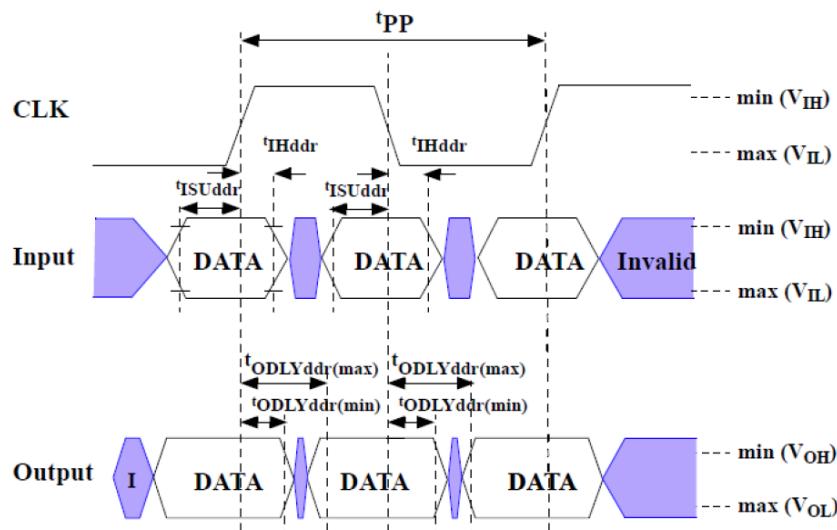


图 4-3 DDR 模式时序图



3、如果 CLK 采样边沿慢于有效 CMD

主机端可以调整 RB_TUNNE_CMD_0，设置 CMD 输出延时，延迟值=0.2ns * RB_TUNNE_CMD_0；从机端可以调整 RB_TUNNE_CMD_1，设置 CMD 输入延时，延迟值=0.2ns * RB_TUNNE_CMD_1；

4、如果 CLK 采样边沿快于有效 CMD

主机端可以配置 RB_TUNNE_CLK_0 位，延迟 CLK 输出，延迟=0.2ns * RB_TUNNE_CLK_0；

从机端可以配置 RB_TUNNE_CLK_1 位，延迟 CLK 输入，延迟=0.2ns * RB_TUNNE_CLK_1；

通过 3 和 4 的配置将有效 CMD 正确对应在 CLK 的采样边沿上。

4.5 中断配置

使能对应的中断配置，可以在及时反馈数据/命令收发的状态。配置中断使能寄存器 (R16_EMMC_INT_EN)，使能需要开启的中断，配置完后，调用 NVIC_EnableIRQ (SDMMC IRQn) 函数，使用快速中断。进行函数编写，可在中断中处理对应的操作。

```
void SDMMC_IRQHandler (void) __attribute__((interrupt("WCH-Interrupt-fast")))
void SDMMC_IRQHandler( void )
{
    If(Interruptflag) {
        .....
        .....
    }
    Clear Interruptflag;
}
```

处理完后，对中断标志寄存器 (R16_EMMC_INT_FG) 进行写 1，清除中断标志。

第5章 eMMC 驱动流程实例

eMMC 定义了多种运行模式，本章节介绍了几种模式的配置流程和注意事项，以下表格总结了几种模式的一些特性。

表 5-1 eMMC 模式

模式名称	采样边沿	I0 电压	数据位宽	时钟频率	理论上最大传输数据量 (8 线)
向后兼容旧版 MMC 卡	单边沿	3V/1.8V/1.2V	1, 4, 8	0~26 MHz	26 MB/s
High Speed SDR	单边沿	3V/1.8V/1.2V	1, 4, 8	0~52 MHz	52 MB/s
High Speed DDR	双边沿	3V/1.8V/1.2V	4, 8	0~52 MHz	104 MB/s
HS200	单边沿	1.8V/1.2V	4, 8	0~200 MHz	200 MB/s
HS400	双边沿	1.8V/1.2V	8	0~200 MHz	400 MB/s

5.1 High Speed SDR 配置流程

1. 上电 3.3V，必须保持初始频率≤400KHz。

```
RCC_HB1PeriphClockCmd(RCC_HB1Periph_PWR, ENABLE);
PWR_VI018ModeCfg(PWR_VI018CFGMODE_SW);
PWR_VI018LevelCfg(PWR_VI018Level_MODE3);
```

调用上述函数，将 I0 电平模式切换成软件配置模式，配置初始化时的数据线的高电平为 3.3V。

配置 R16_EMMC_CLK_DIV 寄存器的 RB_EMMC_CLKMode 位为低速模式，RB_EMMC_DIV_MASK 写入合适的值，计算出的 SDMMC 输出频率小于 400kHz。例程中：SYSPLL_SEL 配置为 600M，RB_EMMC_DIV_MASK 配置为 0x1F，实际输出的 SDMMC_CLK=600M/0x1F/64=302kHz。

2. 循环发送 CMD0 (GO_IDLE_STATE)：发送硬件复位命令，使 eMMC 进入 Idle 状态。

该指令最大循环发送 74 个循环，当控制器反馈无错误，即可退出。

3. 循环发送 CMD1 (SEND_OP_COND)。

参数设置：Argument = 0x40FF8080

循环发送，协商工作电压 (3.3V/1.8V) 和主机能力。

等待 r3 回复的最高位为 1 时，退出循环。

4. 发送 CMD2 (ALL_SEND_CID)：等待 R2 回复，获取卡片 CID。

表 5-2 CID 信息

Name	Width	CID-Slice
Manufacturer ID	8	[127:120]
Reserved	6	[119:114]
Device/BGA	2	[113:112]
OEM/Application ID	8	[111:104]
Product name	48	[103:56]

Product revision	8	[55:48]
Product revision	32	[47:16]
Manufacturing date	8	[15:8]
CRC7 checksum	7	[7:1]
not used, always “1”	1	[0:0]

5. 发送 CMD3 (SET_RELATIVE_ADDR)：为卡片分配相对地址 (RCA)。

例程中配置的 RCA 为 0xA86，发送 CMD 时的参数设置为 $\text{RCA} \ll 16$: Argument = 0xA860000。

6. 发送 CMD9 (SD_CMD_SEND_CSD)：获取卡片的 CSD 信息。

参数设置: Argument = $\text{RCA} \ll 16$, 等待返回的对应的数据。

7. 发送 CMD7 (SELECT_CARD)：通过 RCA 选中目标卡片，进入传输模式 (Transfer State)。

8. 发送 CMD8 (SEND_EXT_CSD)

用于读取 512 字节的 Ext_CSD 寄存器，详见《Embedded Multi-Media Card (eMMC) Electrical Standard (5.1)》P173。

重点检查[196] DEVICE_TYPEG 字段：支持的模式类型，用于判断后续是否可以切换模式提高读写速度。

检查 [189] CMD_SET_REV 字段：支持的 eMMC 协议版本。

检查[215:212] SEC_COUNT 字段：eMMC 卡的块数

检查[61] DATA_SECTOR_SIZE 字段：单块的容量，一般为 512B

通过块数和单块的容量，可以计算出 eMMC 卡的总的容量：SEC_COUNT*DATA_SECTOR_SIZE

9. 发送发送切换指令 CMD6 (SWITCH_FUNCTION)：

参数设置: Argument = 0x03B70200

上述命令操作，用于通知 eMMC 卡，切换为 8 线传输模式。(如果使用四线模式，指令可以换成 Argument = 0x03B70100)

此时，切换 SDMMC 控制器，R16_EMMC_CONTROL 寄存器的 RB_EMMC_LW_MASK 位，设置成收发器使用 D[7:0]，8 数据线。(如果使用四线模式，RB_EMMC_LW_MASK 同样设置成四线)

10. 发送切换指令 CMD6 (SWITCH_FUNCTION)：

参数设置: Argument = 0x03B90100

[31:24] = 0x03: 访问模式 (写 Ext_CSD)

[23:16] = 0xB9: 目标寄存器 (HS_TIMING)

[15:8] = 0x01: 写入值 (0x01=HS 模式)

完成 High Speed SDR 模式的配置完成。配置完可以再次读取 Ext_CSD，查看是否已经配置上对应的值。

11. 将 SDMMC 控制器时钟从初始频率 (400KHz) 提升至 52MHz。

完成上述流程即可正常收发数据。

5.2 High Speed DDR 配置流程

低速双边沿采样模式，可以提高一倍的速率，在 5.1 的前提操作下，发送发送切换指令 CMD6

(SWITCH_FUNCTION)，参数设置：Argument = 0x03B70600，通知 eMMC 卡，切换为 8 线传输的 DDR 模式，即 High Speed DDR 模式。注意，必须在 HS_TIMING 的值为 1 时，才能配置 DDR 模式。（包括四线 DDR，Argument = 0x03B70500）

5.3 HS200 配置流程

基于 5.1 High Speed SDR 模式，我们想进一步提高速度，需要再往下配置（5.1 的第 8 条中提到的支持更高速模式的前提下）：

1、切换 IO 电压为 1.8/1.2V，需参照 eMMC 手册，查看可以配置的电压。

例程中将电压切换至 1.8V：PWR_VI018LevelCfg(PWR_VI018Level_MODE1)；

2、发送切换指令 CMD6 (SWITCH_FUNCTION)：

参数设置：Argument = 0x03B90200

[31:24] = 0x03：访问模式（写 Ext_CSD）

[23:16] = 0xB9：目标寄存器（HS_TIMING）

[15:8] = 0x02：写入值（0x02=HS200 模式）

完成 HS200 模式的配置完成。配置完可以再次读取 Ext_CSD，查看是否已经配置上对应的值。

3、切换 SDMMC 控制器的时钟。

例程中，设置配置 R16_EMMC_CLK_DIV 寄存器的 RB_EMMC_CLKMode 位为高速模式，如果 SYSPLL_SEL 配置为 600M，RB_EMMC_DIV_MASK 配置为 0x3，将 SDMMC_CLK 输出 200MHz。

4、发送 CMD21 (Send Tuning Block)，然后配置成接收模式，接收 128B 的数据，对照

《Embedded Multi-Media Card (eMMC) Electrical Standard (5.1)》P53 的 Tuning block pattern for 8 bit mode，如果一致，则时序为最优时序，否则即按照 4.4 章节调整，直至数据对应准确。

5.4 HS400 配置流程

在 5.3 的基础上，还可以将速度再次进行翻倍，进入 HS400 模式，按照如下配置。

1、SDMMC_CLK 降至 52M 以下，进入 High Speed DDR 模式，具体流程详见 5.2 章节。

2、发送切换指令 CMD6 (SWITCH_FUNCTION)：

参数设置：Argument = 0x03B90300

[31:24] = 0x03：访问模式（写 Ext_CSD）

[23:16] = 0xB9：目标寄存器（HS_TIMING）

[15:8] = 0x03：写入值（0x03=HS400 模式）

3、将速度再次提升至 200MHz，按照 5.3 的 4 进行时序调节。

历史版本

更新内容

日期	版本	变更内容
2025/9/15	V1.0	初版发行

声明

本手册版权所有为南京沁恒微电子股份有限公司 (Copyright © Nanjing Qinhe Microelectronics Co., Ltd. All Rights Reserved), 未经南京沁恒微电子股份有限公司书面许可, 任何人不得因任何目的、以任何形式（包括但不限于全部或部分地向任何人复制、泄露或散布）不当使用本产品手册中的任何信息。

任何未经允许擅自更改本产品手册中的内容与南京沁恒微电子股份有限公司无关。

南京沁恒微电子股份有限公司所提供的说明文档只作为相关产品的使用参考, 不包含任何对特殊使用目的的担保。南京沁恒微电子股份有限公司保留更改和升级本产品手册以及手册中涉及的产品或软件的权利。

参考手册中可能包含少量由于疏忽造成的错误。已发现的会定期勘误, 并在再版中更新和避免出现此类错误